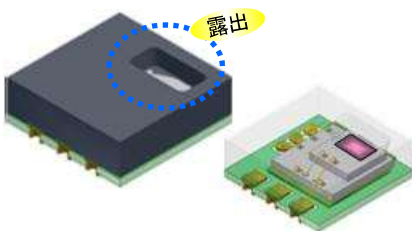


半導体・センサパッケージング

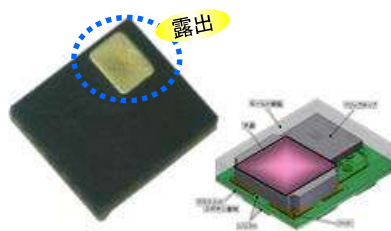
各種半導体やセンサの用途・特性に合わせた最適なパッケージングを提供いたします。

部分露出パッケージ

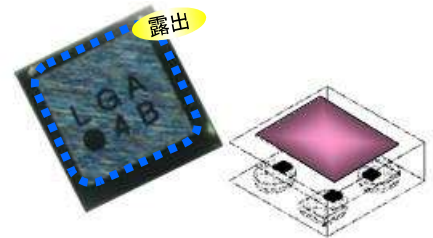
■目的に合わせてデバイスや部品の一部を露出



湿度や圧力など外界と接するセンサ向け



高さのある部品を露出し低背化対応

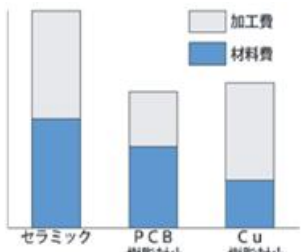


発熱の多いチップを露出し放熱対応

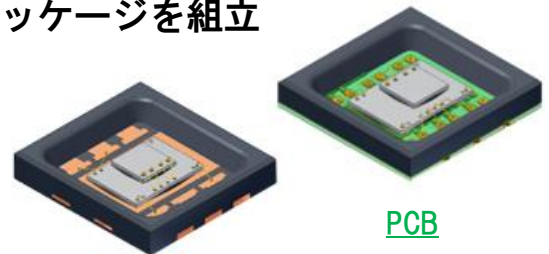
中空パッケージ

■直接封止できないデバイスに最適

■熱硬化性樹脂を使用し低コストでの中空パッケージを組立



断面図



銅(Cu)基板

PCB

コネクティブタイプパッケージ

■アプリケーションに合わせた多段形状、モジュール化によりダイレクトな接続・設置

■部品保護と後組部品接続形状の一括成形により低コスト化



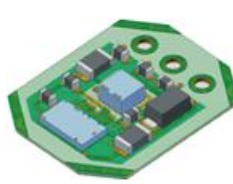
表面図

デバイスの部分露出



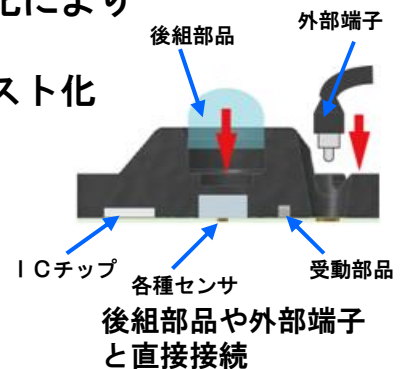
断面図

表裏両面の多段成形



内部構造図

モジュール化



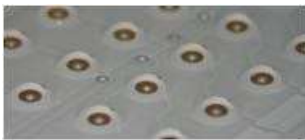
半導体・センサパッケージング

各種半導体やセンサの用途・特性に合わせた最適なパッケージングを提供いたします。

透明樹脂封止パッケージ

■ ディスペンス条件により様々な形状にLEDを形成

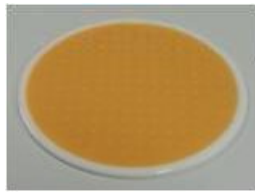
〔シリコンCOB〕



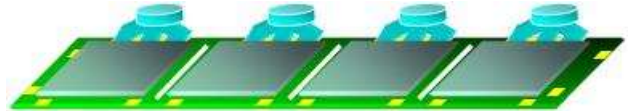
〔パッケージタイプ〕



〔ダム材+封止(蛍光体)〕



■ トランスファー成形一括封止による透明樹脂封止
MAP基板方式により反りを最小限に抑え多数個取りを実現



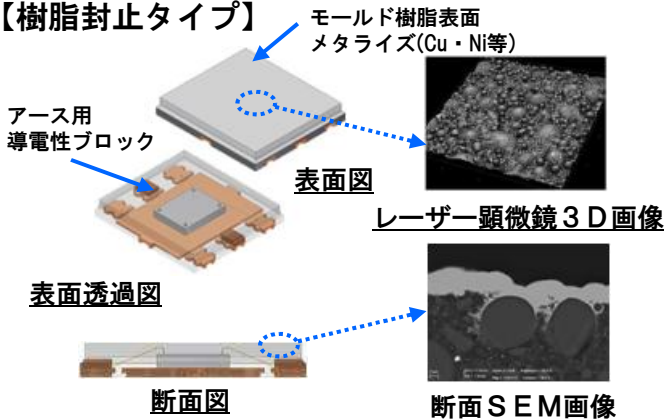
<信頼性試験結果>

- ・吸湿/リフロー剥離試験 : 合格
(125°C/24H→30°C/60%/192H
→リフロー MAX260°C×3回)
⇒判定基準: パッケージ面積の10%以下
- ・ワイヤ断線テスト : 合格
(温度サイクル -40°C~85°C/30min保持/300cyc)
⇒判定基準: Open/Short TEST OKのこと
- ・パッケージ組立性評価 : 合格
⇒流動性に問題がないこと

ノイズ対策パッケージ

■ 電子機器の誤作動故障の原因となるノイズを部品レベルで対策
シールド構造により、放射ノイズやノイズ干渉の少ないパッケージ

【樹脂封止タイプ】



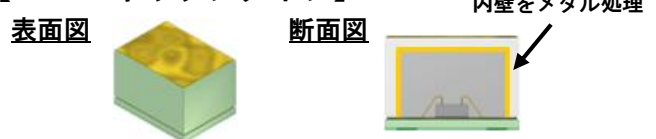
- ・各種パッケージ・インターポーザの選択が可能
- ・表面メタライズとGNDとの接続が可能
- ・表面メタライズとモールド樹脂の高い密着性

【メタルキャップタイプ】



メタルキャップに加え、デバイス下面にメタル層を追加することでデバイス下面のノイズ対策

【PCBキャップタイプ】



キャップをMAP上に配置し封止・ダイシングを一括にて行うことで組立コストの削減・小型化



Beyond The Imagination
想像を超え、創造へつなげる

アルス株式会社

<http://www.arusu.co.jp>

本社 福島県本宮市本宮字名郷7番地
TEL 0243-33-2326(代表)
FAX 0243-33-5245